



2009年3月期(08年度) 第3四半期決算説明会

2009年2月13日
株式会社 東京精密
代表取締役社長 藤森 一雄
代表取締役CFO 太田 邦正



将来の事象に係わる記述に関する注意

- ◆ 本プレゼンテーション資料及び当社代表者が口頭にて提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ◆ これらは、市況、競争状況、ならびに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ◆ 従いまして、実際の今後の当社の業績が、本プレゼンテーションにおける記述、情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。



(株)東京精密 2009年3月期(08年度) 第3四半期決算説明会

次第

| | | | |
|------|------|---------------------------------------|-------|
| 4:00 | | 開会 | |
| 4:00 | 4:10 | 2008年度第3四半期業績説明 代表取締役CFO | 太田 邦正 |
| 4:10 | 4:20 | 2008年度通期見通し 市場環境と当社への対応 代表取締役社長 | 藤森 一雄 |



第3四半期(累計)業績

単位: 億円

| | 06年度 | 07年度 | 08年度 | YoY |
|-------------|------|------|------|-----|
| 売上高 | 714 | 693 | 396 | 43% |
| 半導体 | 554 | 518 | 225 | 57% |
| 計測 | 160 | 175 | 171 | 2% |
| 営業利益 | 113 | 79 | 10 | 87% |
| 半導体 | 75 | 37 | 23 | - |
| 同率 | 14% | 7% | - | - |
| 計測 | 38 | 42 | 33 | 21% |
| 同率 | 24% | 24% | 19% | 21% |
| 経常利益 | 110 | 78 | 6 | 92% |
| 当期利益 | 60 | 42 | 89 | - |



第3四半期実績：四半期推移

単位：億円

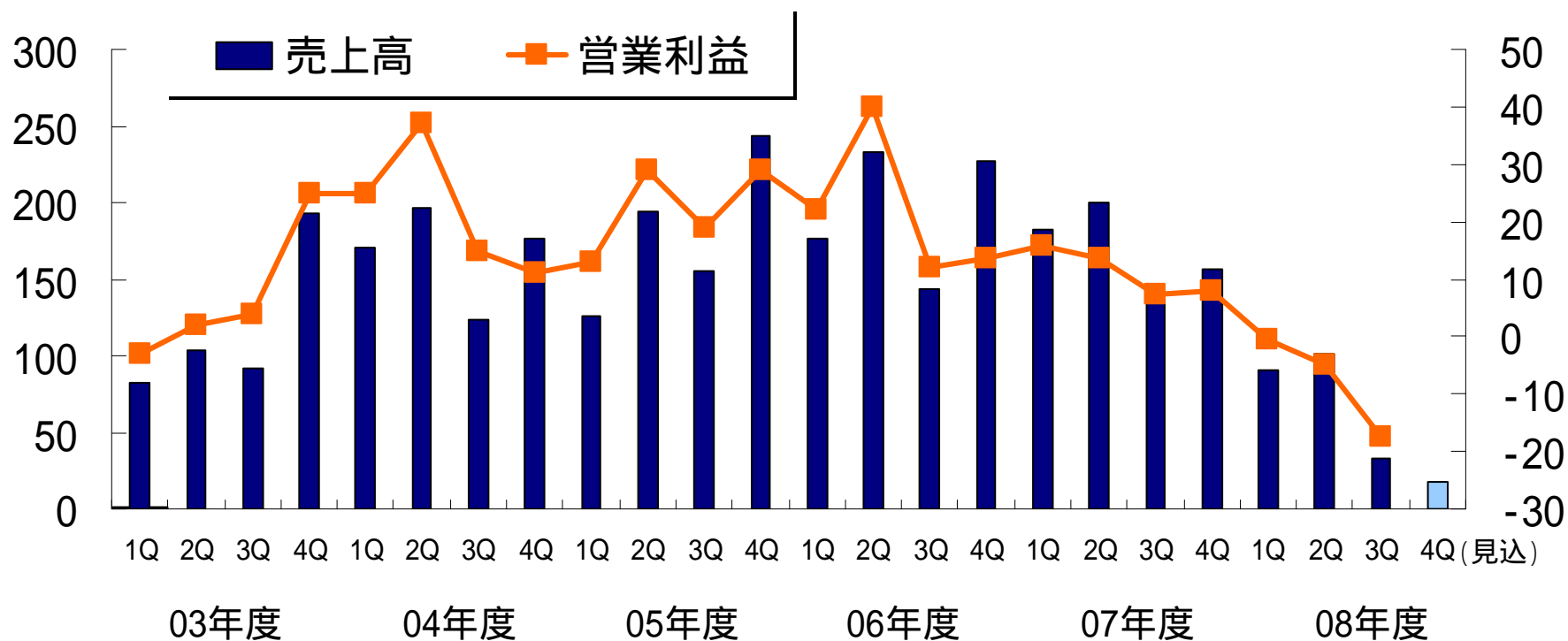
| | 2007年度 | | | | 2008年度 | | | |
|-------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | YoY |
| 売上高 | 231 | 268 | 195 | 225 | 149 | 169 | 78 | 60% |
| 半導体 | 182 | 200 | 136 | 157 | 91 | 101 | 32 | 76% |
| 計測 | 49 | 68 | 59 | 68 | 58 | 68 | 46 | 22% |
| 営業利益 | 27 | 32 | 20 | 26 | 12 | 9 | 11 | - |
| 半導体 | 16 | 14 | 7 | 8 | 1 | 5 | 17 | - |
| 同率 | 9% | 7% | 5% | 5% | - | - | - | - |
| 計測 | 11 | 19 | 12 | 18 | 13 | 14 | 6 | 49% |
| 同率 | 22% | 28% | 20% | 26% | 22% | 21% | 14% | 35% |
| 経常利益 | 29 | 30 | 19 | 16 | 17 | 8 | 20 | - |
| 当期利益 | 15 | 18 | 9 | 6 | 6 | 4 | 87 | - |



半導体事業の業績推移

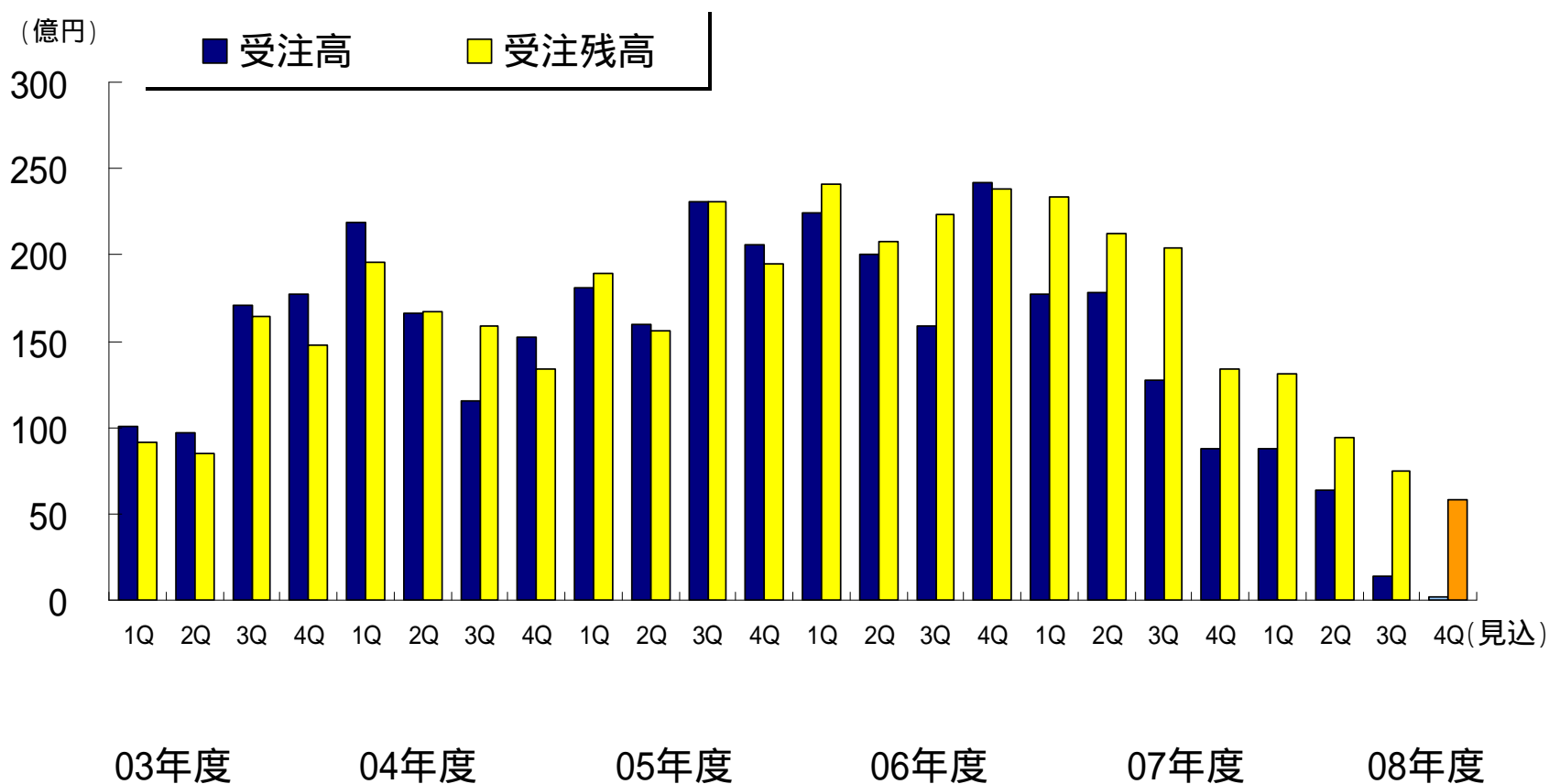
売上高
(億円)

営業利益
(億円)



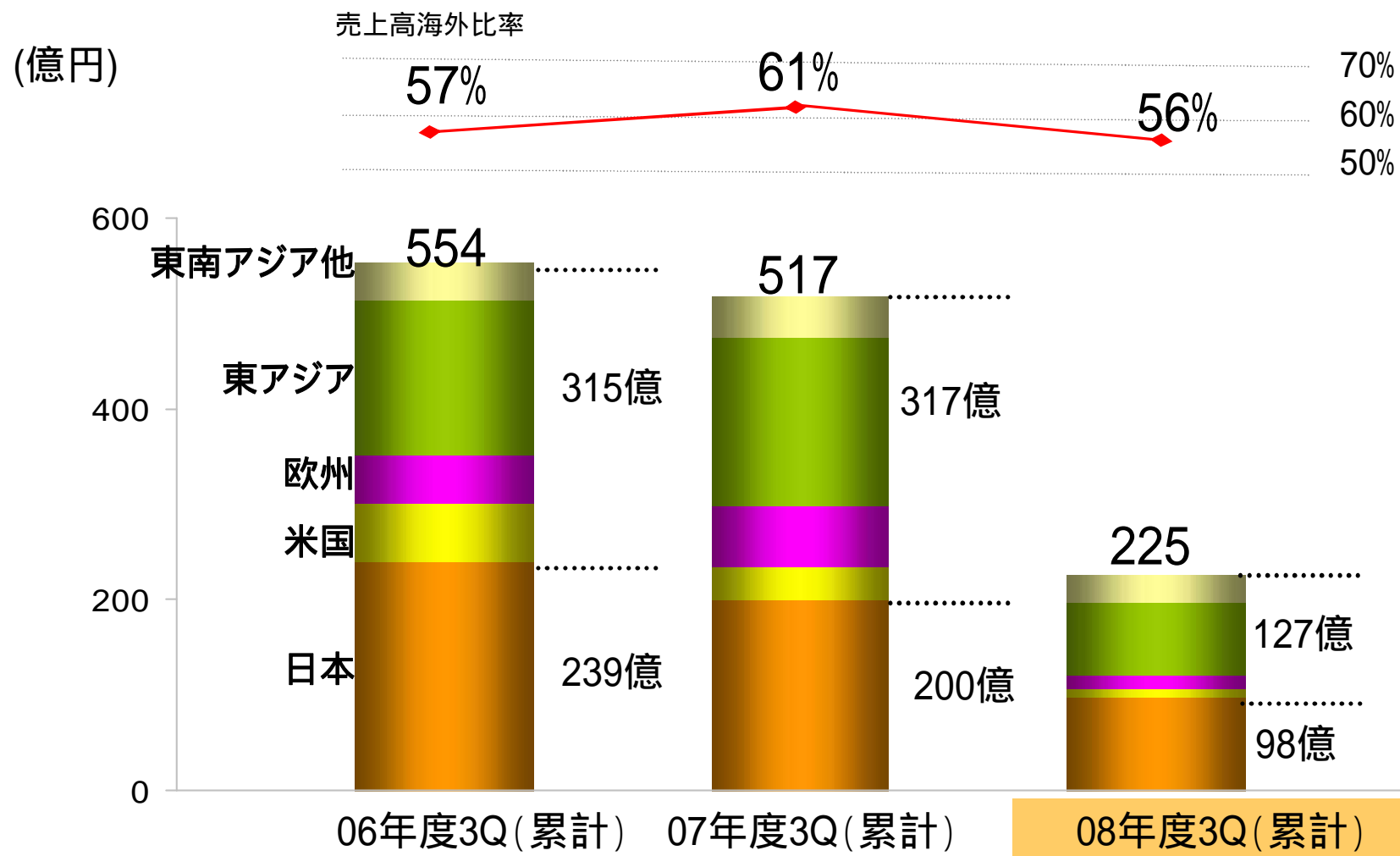


半導体事業の受注推移





半導体事業の地域別売上高推移

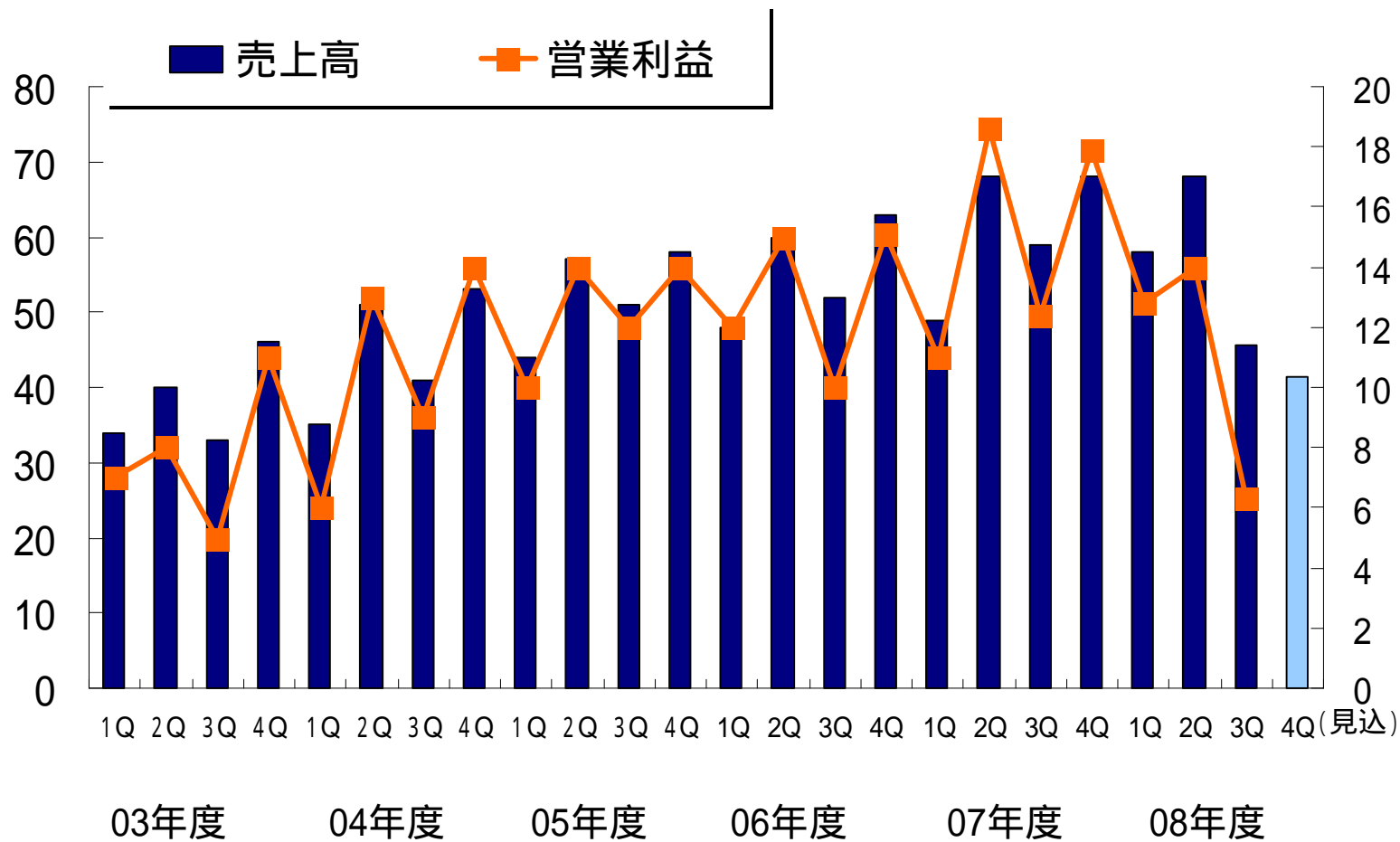




計測事業の業績推移

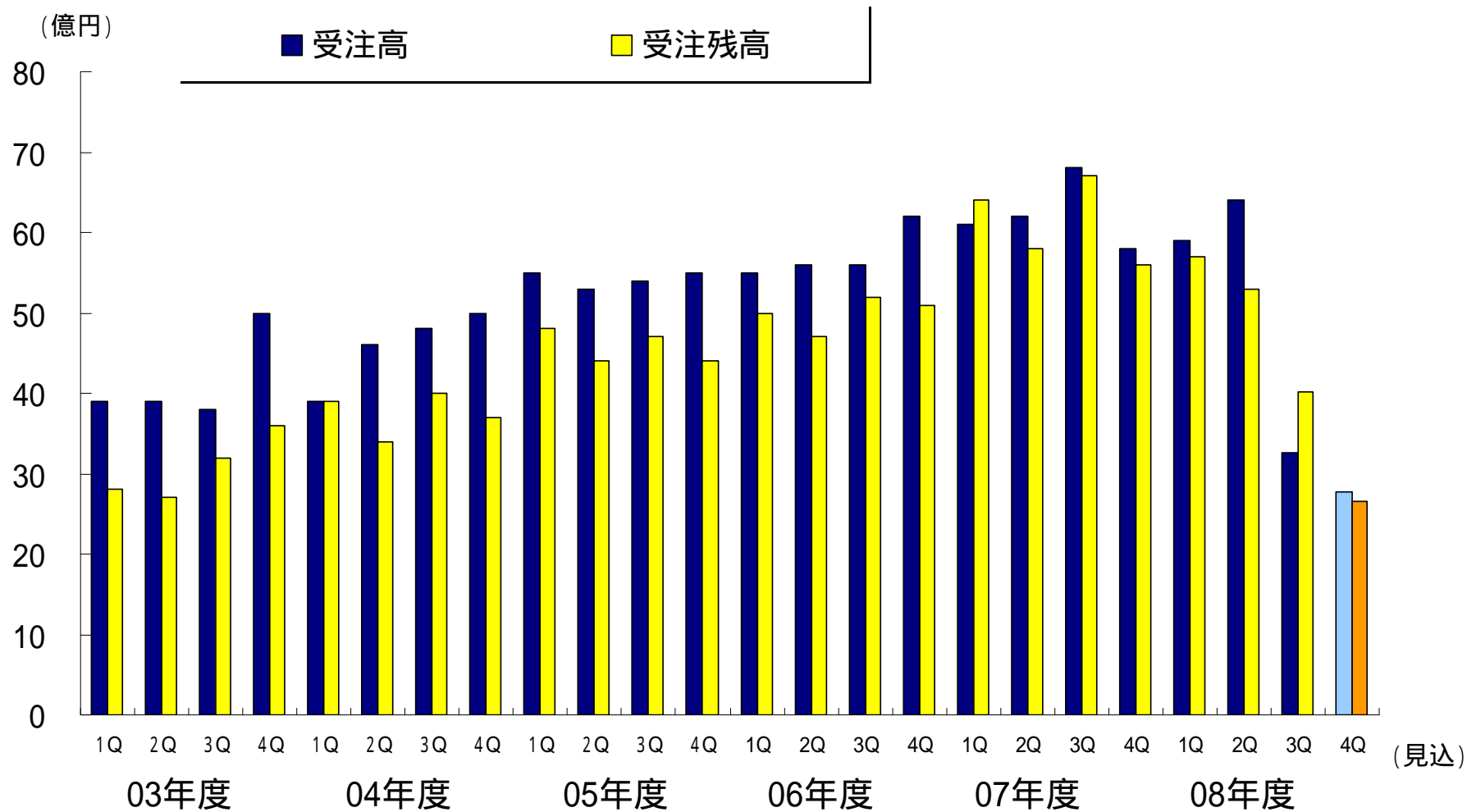
売上高
(億円)

営業利益
(億円)



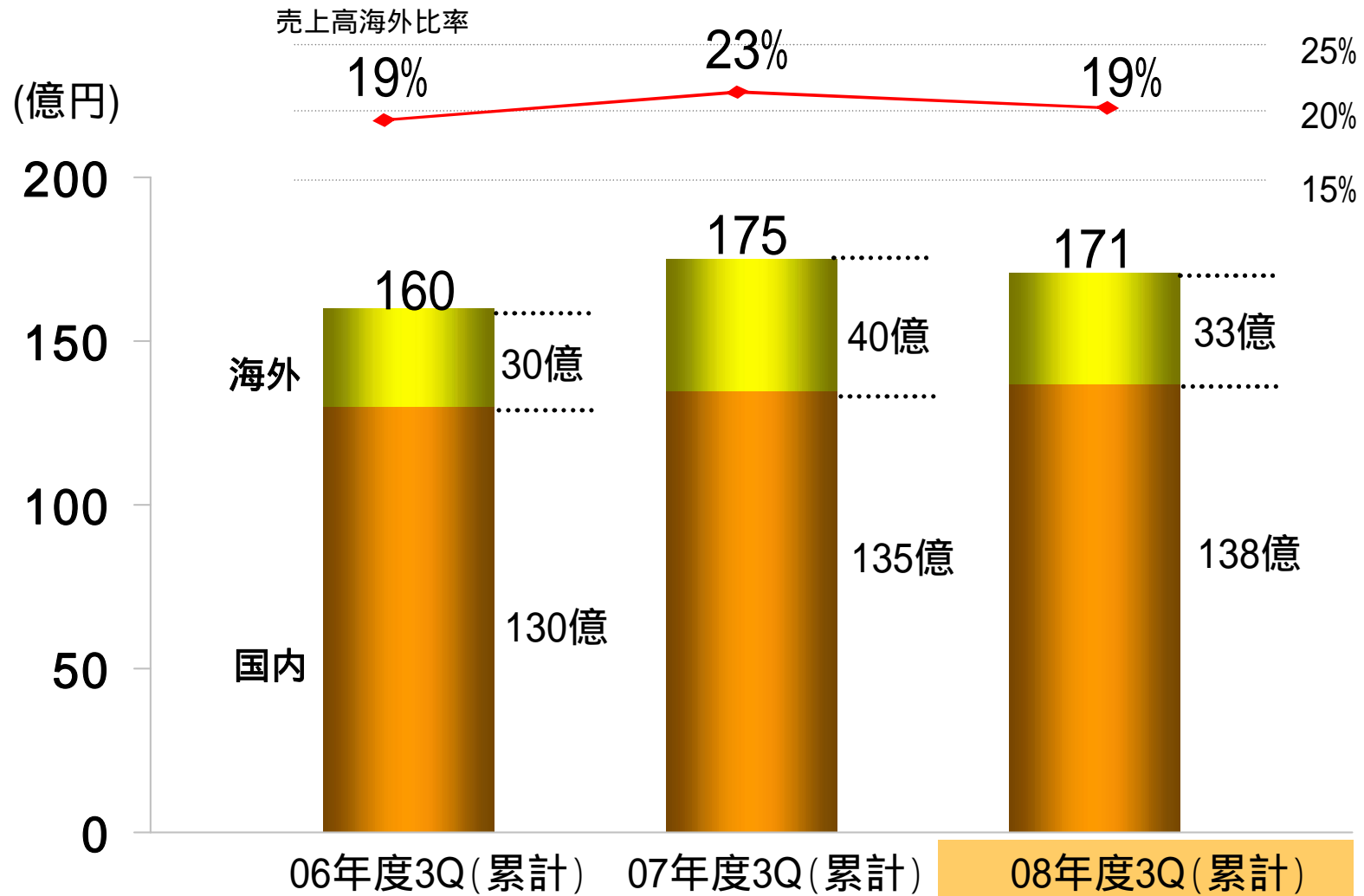


計測事業の受注推移





計測事業の地域別売上高





貸借対照表

(単位:億円)

| 資産 | 08/3 末 実績 | 08/12 末 実績 | 増減額 | 負債/総資産 | 08/3 末 実績 | 08/12 末 実績 | 増減額 |
|--------------|-----------------|------------------|-----|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 現預金 | 157 | 128 | 29 | 支払手形・ 買掛金 | 195 | 103 | 92 |
| 受取手形・ 売掛金 | 323 | 190 | 133 | 借入金・社債 | 184 | 105 | 79 |
| 在庫 | 277 | 199 | 78 | その他 | 66 | 33 | 33 |
| その他 | 19 | 19 | 0 | 流動負債計 | 445 | 241 | 204 |
| 流動資産計 | 776 | 536 | 240 | 固定負債計 | 77 | 172 | 95 |
| 固定資産計 | 301 | 310 | 9 | 負債計 | 522 | 413 | 109 |
| 資産合計 | 1,077 | 846 | 231 | 純資産 | 555 | 433 | 122 |
| | | | | 負債・純資産 合計 (内有利子負債) | 1,077 (219) | 846 (233) | 231 (14) |



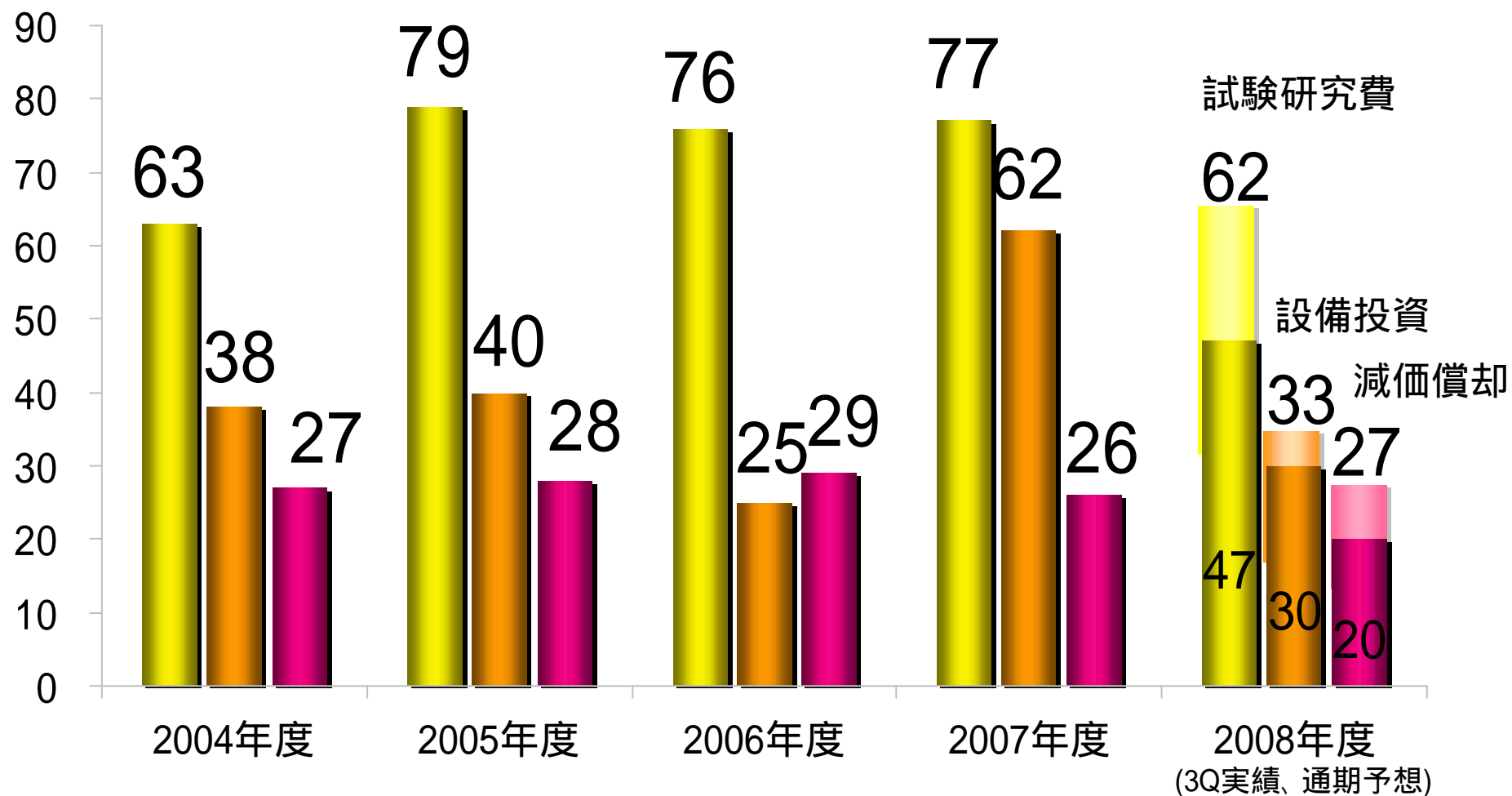
キャッシュフロー

| (単位:億円) | | 06年度3Q実績 | 07年度3Q実績 | 08年度3Q実績 |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|
| 現金等 期首残高 | | 139 | 168 | 157 |
| 営業活動 | 税引前・利払前・償却前利益 | 128 | 98 | 69 |
| | (売上債権+在庫) - 仕入債務 | 79 | 8 | 119 |
| | 納税 | 18 | 46 | 25 |
| | その他 | 13 | 15 | 2 |
| 小計 | | 44 | 29 | 27 |
| 投資活動 | | 21 | 54 | 31 |
| フリーキャッシュフロー | | 23 | 25 | 4 |
| 財務活動 | 社債・借入 | 14 | 4 | 0 |
| | 配当金等 | 16 | 22 | 22 |
| | 小計 | 30 | 18 | 22 |
| 増減額 | | 6 | 41 | 29 |
| 現金等 期末残高 | | 133 | 127 | 128 |



試験研究費、設備投資、減価償却

(億円)





(株)東京精密 2009年3月期(08年度) 第3四半期決算説明会

次第

| | | | |
|------|------|--------------------------------------|-------|
| 4:00 | | 開会 | |
| 4:00 | 4:10 | 2008年度第3四半期業績説明 代表取締役CFO | 太田 邦正 |
| 4:10 | 4:20 | 2008年度通期見通し 市場環境と当社の対応 代表取締役社長 | 藤森 一雄 |



通期予想

| 単位: 億円 | 07年度 | 08年度 | | | 08年度 | | | YoY |
|-------------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | 通期 | 従来予想 | | | 今回予想 | | | |
| | | 上期 | 下期 | 通期 | 上期実績 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | 918 | 318 | 212 | 530 | 318 | 137 | 455 | 50% |
| 半導体 | 675 | 192 | 108 | 300 | 192 | 50 | 242 | 64% |
| 計測 | 244 | 126 | 104 | 230 | 126 | 87 | 213 | 13% |
| 営業利益 | 105 | 21 | 6 | 15 | 21 | 46 | 25 | - |
| 経常利益 | 94 | 26 | 15 | 11 | 26 | 56 | 30 | - |
| 当期利益 | 48 | 2 | 14 | 16 | 2 | 118 | 120 | - |
| 配当 | 70円 | 15円 | 10円 | 25円 | 15円 | 0円 | 15円 | - |



事業見直しと特別損失計上

- ◆ 外観検査装置事業： 関連特損4.7億円
 - 新規開発取止め
 - 既存機のサポート継続
- ◆ 米国事業の再構築： 関連特損2.5億円
 - デバイスエッジ開発凍結
 - 会社清算
- ◆ その他の特損
 - 希望退職特別加算金、株式評価損
 - 下期特別損失合計： 8.2億円程度を予定



マーケット概況

◆半導体

- 2009年度は前年比マイナスの覚悟
- 2010年には上昇へ転じる

◆計測

- 自動車関連産業の低迷で2009年度市況は厳しい
- 回復には時間を要する



当面の対応(1)

◆売上確保へ

- 試験研究投資の取込み
- 改造・レトロフィットの取込み
- 受託加工・受託計測
- サービス事業の推進(保守契約・消耗品)



当面の対応(2): 固定費削減

◆ 人件費削減

(単位:人)

➤ 人員削減

| | 08/3末 | 08/9末 | 09/上期 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 従業員数(正社員 + 臨時従業員) | 2,198 | 2,020 | 1,200 |

➤ 09年度上期は、合計1,200名体制を目指す。

- ・ 臨時従業員圧縮、
- ・ 定年退職による自然減、
- ・ 希望退職者募集、

➤ 報酬減額・給与減額

◆ その他経費削減



回復期に向けての対応：半導体

◆ 開発戦略

- 最終製品の販売トレンドを踏えた開発推進
 - ターゲット絞り込み SSDカード / 高輝度LED / MEMS

◆ 体制

- 少人数での効率対応
 - 開発：製品縦割り体制から
製品・機能(メカ・ソフト等)マトリクス運営へ
 - 製造：混流生産、多能工化の徹底推進



回復期に向けての対応：計測

◆開発戦略

- 製品ラインアップの拡充
 - 省エネモデル
 - 自動車以外(風力発電・航空機、他)
 - 海外向け機種
- 新ソフトウェアによる差異化

◆体制

- 新工場による生産革新：変動に対応できる生産体制
- 計測センター活用によるサービス事業(受託計測など)



ACCRETECH



東京精密は
アクレーテクです